

江苏雅克科技股份有限公司

关于投资建设“年产2.4万吨电子材料项目”的公告

特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本投资项目涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数，与实际投入可能存在差异。项目的资金为自有或自筹资金，存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法完成的风险。

2、本次对外投资不排除受国家或地方有关政策调整等实施条件因素发生变化而导致的项目变更、延期、中止或终止的风险。受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，项目可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。

江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于投资建设“年产2.4万吨电子材料项目”的议案》，同意全资子公司雅克先科(成都)电子材料有限公司（以下简称“雅克先科”）在四川省成都市彭州市投资建设“年产2.4万吨电子材料项目”（以下简称“本次投资事项”）。具体情况如下：

一、项目概况

为进一步完善公司硅微粉业务的产业链条，提高企业竞争力，促进企业健康有序发展，公司拟投资建设“年产2.4万吨电子材料项目”，预计项目总投资约89,706.34万元，总建设周期约为2年，资金来源主要为企业自有或自筹。

截至2024年7月31日，“年产2.4万吨电子材料项目”累计投资金额为人民币41,630.43万元，项目尚未建设完成。鉴于电子粉体材料在相关工业化生产中的广泛应用，公司持续看好球形二氧化硅和球形氧化铝等电子粉体材料的未来发展前景，故计划在现有项目建设进度基础上，继续对本项目进行投资。公司启动对本项目的进一步投资后，预计本次投资事项的投资总额将超过公司《总

经理工作细则》规定的总经理审批权限但暂未达到公司股东大会审议标准，因此已将本次投资事项整体提交公司董事会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。根据项目推进进展，如果项目的后续投资规模进一步扩大，达到股东大会审议标准，公司将按照相关规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

二、投资主体基本情况

公司名称：雅克先科(成都)电子材料有限公司（以下简称“雅克先科”）

统一社会信用代码：91510182MAC6NUP94R

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：10,000.00万人民币

成立日期：2022年12月28日

法定代表人：沈琦

住所：四川省成都市彭州市远航大道120号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；新材料技术研发；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：雅克科技持有雅克先科100%股权。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：年产2.4万吨电子材料项目

2、项目地址：四川省成都市彭州市

3、投资规模：预计投资人民币89,706.34万元（具体以实际为准）。公司最近一期（2023年底）经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）为人民币690,808.06万元，本项目预计投资规模将达到最近一期（2023年底）经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）10%以上。

4、资金来源：自有或自筹资金

5、项目主要内容：根据公司发展、市场需求并结合公司在经营管理上的能力，确定此次项目设计产能为年产2.4万吨电子粉体材料。具体生产品种根据市场情况可及时调整。

6、项目建设周期：2023年10月—2025年12月

7、可行性分析

球形硅微粉作为一种无机非金属矿物功能性粉体材料，具有高耐热、高绝缘、低线性膨胀系数和导热性好等独特的物理、化学特性，能够广泛应用于覆铜板、环氧塑封料、电工绝缘材料、胶粘剂、陶瓷、涂料等领域，在消费电子、家用电器、移动通信、汽车工业、航空航天、国防军工、风力发电等行业所需的关键性材料中占有举足轻重的地位，因此硅微粉行业的发展对推动相关产业的技术进步、提升产品的性能和质量发挥着巨大作用，对于缩短我国电子工业与日本等发达国家之间的差距具有重要意义。

球形氧化铝是目前导热散热及高功率芯片方面主要的应用材料。首先，球形氧化铝具有优良的导热性能和高球形度高填充性，是热界面材料的主要原料之一，随着国内电子产品的快速增长，高端电子产品已经对导热散热提出了更高的要求，热界面材料（TIM）是所有电子设备、电源模块、通信、能量存储等应用的关键需求之一。从本质上说，只要系统产生热量并需要散热（例如通过散热器），通常都需要用到热界面材料，市场潜力巨大。另一方面，将球形氧化铝作为芯片封装用填料，其突出特性是导热率更高，芯片产出的热量易于散出，一般用于算力芯片、多芯片产品；目前广泛应用于AI训练、推理的存储芯片——HBM（High Bandwidth Memory，高带宽存储器），球形氧化铝是必不可少的关键填料

雅克科技在收购浙江华飞电子基材有限公司的股权以后，致力于包括球形二氧化硅等微细电子粉体产品的开发和生产，公司在研发生产二氧化硅封装材料的同时也早早开始球形氧化铝的生产研发，并取得了技术上的突破，打破了国外的技术垄断。

经过多年的研究和实践，公司已掌握高温熔融法、燃爆法等行业领先的粉体制造工艺，生产的产品性能和品质达到了国外先进水平，在电子行业也有着广阔的应用范围。本次项目的实施将有助于公司在市场竞争中占得先机，实现公司的壮大与发展。

四、本次投资的目的、对公司的影响、存在的风险

1、本次投资的目的

本次投资源于公司对硅微粉业务发展前景的持续看好，有利于进一步完善

公司业务布局，促成公司规划建设高附加值硅微粉制造项目。项目建成后可以进一步完善公司在硅微粉业务方面的产业链条，提高企业竞争力，促进企业健康有序发展，符合企业发展战略。

2、对公司的影响

本次项目投资是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务并结合公司市场判断进行的拓展，有利于公司进一步扩大市场份额，提升综合竞争实力，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，符合公司整体发展战略规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

本投资项目符合公司的战略发展需要，有利于提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，预计对公司2024年度经营业务不构成重大影响，但对公司长远发展会有积极影响。

3、存在风险

(1) 本投资项目涉及的投资金额、建设周期等均为计划数或预估数，与实际投入可能存在差异。项目的资金为自有或自筹资金，存在项目资金无法按期到位导致项目延期、变更或无法完成的风险。

(2) 本次对外投资不排除受国家或地方有关政策调整等实施条件因素发生变化而导致的项目变更、延期、中止或终止的风险。受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，项目可能存在如未能按期建设完成、未能达到预期收益等风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏雅克科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日